

06.1;06.2;06.3

©1994

**КОРОТКОВОЛНОВАЯ  
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
ПОВЕРХНОСТНО-БАРЬЕРНЫХ СТРУКТУР  
НА ОСНОВЕ ПЕРЕХОДОВЫЙ ВЫРОЖДЕННЫЙ  
ПОЛУПРОВОДНИК-ПОЛУПРОВОДНИК**

*Ю.Н.Бобренко, А.М.Павелец, С.Ю.Павелец, В.М.Ткаченко*

Интерес к фотопреобразователям (ФП) ультрафиолетового (УФ) диапазона спектра определяет актуальность исследований коротковолновой чувствительности поверхностно-барьерных структур. В исследованных в настоящей работе поверхностно-барьерных структурах вместо металла использовался вырожденный полупроводник — стабильная модификация сульфида меди  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  [1–6]. Концентрация дырок в сульфиде меди  $p = 5 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-3}$ .  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  наносился в вакууме на поликристаллический слой  $\text{CdS}$  с концентрацией электронов  $10^{15} \text{ см}^{-3}$ . Для исследования пропускания слой  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  параллельно наносился на кварцевые стекла.

На рис. 1 приведена зонная диаграмма гетероперехода  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}-\text{CdS}$  [7]. Особенностью диаграммы является наличие дополнительных потенциальных барьеров  $\Delta E_c$  и  $\Delta E_v$ , ограничивающих нежелательный для ФП переход носителей тока через границу раздела гетероперехода.

На рис. 2 приведены спектры внешней квантовой эффективности  $Q_e$  ФП с различной толщиной  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$ . Освещение структуры производилось со стороны  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$ . Толщина слоя  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  в известных ФП на основе соединений  $\text{A}_2\text{B}_6$ , как правило, порядка 400 Å [1–6]. Этому случаю соответствует кривая 1 на рис. 2. Ширина запрещенной зоны  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  для прямых оптических переходов  $E_g = 1.6 \text{ эВ}$  [8] и отсутствие чувствительности за краем собственного поглощения  $\text{CdS}$  ( $\lambda 0.51 \text{ мкм}$ ) — см. рис. 2 — свидетельствуют о нефоточувствительности  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  в длинноволновой области спектра, что согласуется с литературными данными [1–3]. Отсутствие тянувшего электрического поля в  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  определяет основной механизм потерь фотоносителей — рекомбинацию на границе раздела.

Выражение для внешней квантовой эффективности в общем виде можно записать как  $Q_e = T Q_i$ , где  $T$  — пропускание слоя  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$ ,  $Q_i$  — внутренняя квантовая эффективность.

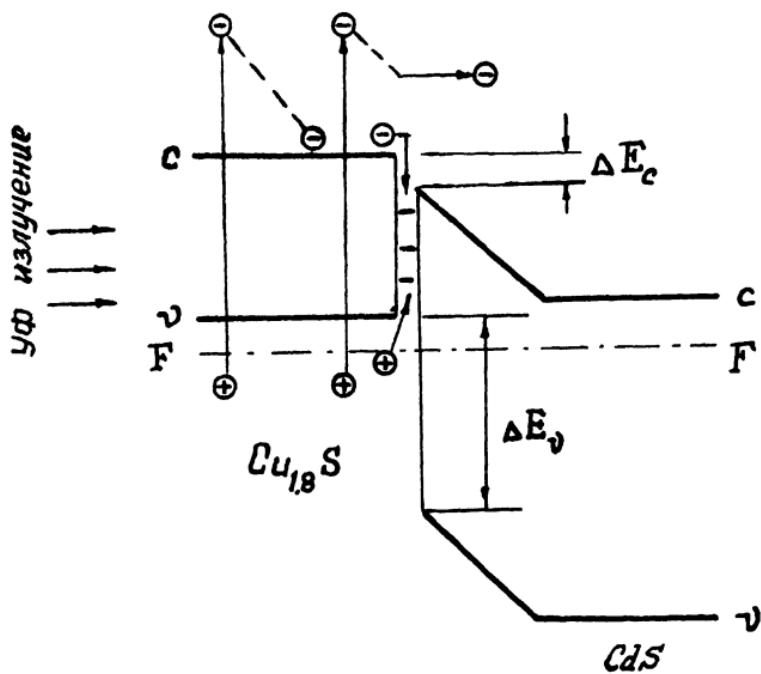


Рис. 1. Энергетическая зонная диаграмма гетероперехода Cu<sub>1.8</sub>S–CdS.

При этом предполагается отсутствие фоточувствительности, связанной с генерацией носителей в Cu<sub>1.8</sub>S. Повышение чувствительности в коротковолновой области спектра возможно путем уменьшения доли нефотоактивного поглощения света в структуре. Этого можно достичнуть путем уменьшения толщины нефотоактивного Cu<sub>1.8</sub>S, т.е. увеличения  $T$ . С другой стороны, предельное уменьшение толщины слоя Cu<sub>1.8</sub>S должно его “очувствовать” в коротковолновой области спектра. Имеется в виду возможность в отличие от контакта металл–полупроводник максимально использовать фотоэмиссию электронов — неосновных носителей тока из прозрачной составляющей в CdS.

Действительно, в случае полупроводника  $n$ -типа проводимости для диодов Шоттки из-за сильного взаимодействия с электронами проводимости в металле энергию, достаточную для преодоления потенциального барьера, сохраняют только те фотоэлектроны, которые образовались вблизи границы раздела на глубине, не превышающей 10 Å. Поскольку толщина слоя металла у диодов Шоттки должна быть порядка 100 Å, большая часть излучения поглощается в металле “нефотоактивно”, не внося вклад в фототок.

В вырожденных полупроводниках, когда фотоэлектроны теряют избыточную энергию в основном при взаимо-

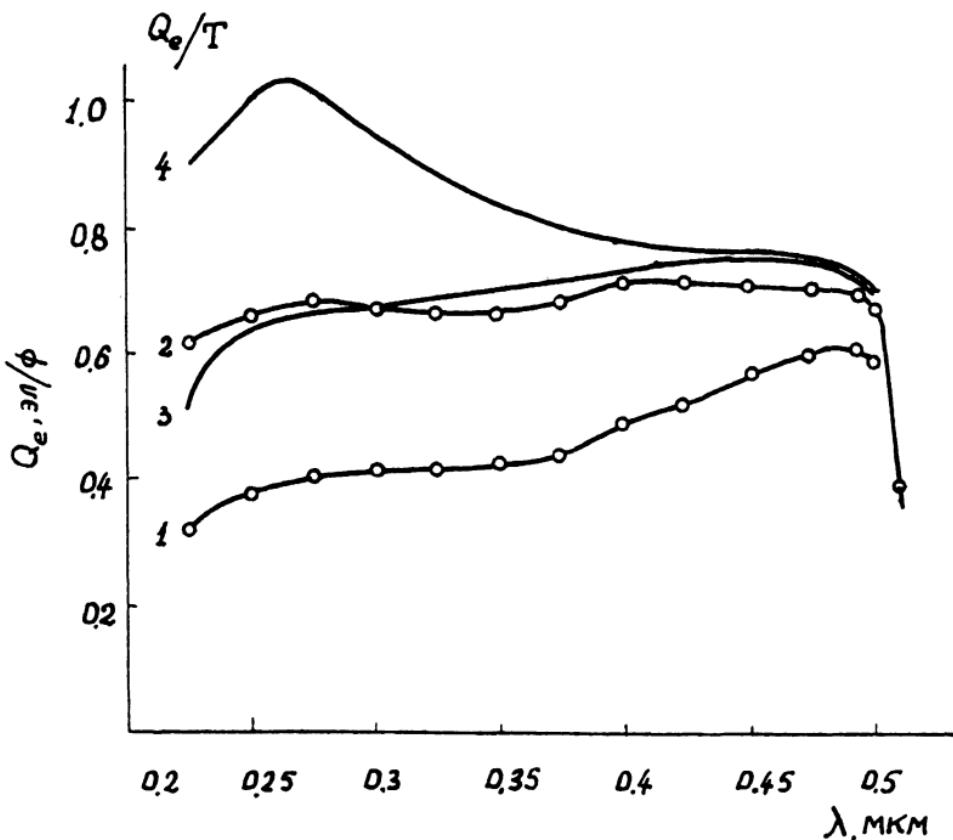


Рис. 2. Спектры внешней квантовой эффективности  $Q_e$  (1-2) поверхностью-барьерной структуры  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}-\text{CdS}$  и спектральное распределение функции  $Q_e/T$  (3-4).

действии с тепловыми колебаниями кристаллической решетки, при избыточной энергии 0.5–1 эВ электрон в процессе остывания может пройти расстояние до нескольких сот ангстрем. При использовании таких толщин следует ожидать заметный вклад в фототок горячих неосновных носителей, генерированных УФ излучением в прозрачной составляющей поверхностью-барьерной структуры. Как видно из рис. 1, термализованные электроны, подходя к границе раздела, рекомбинируют с дырками, для которых существует барьер  $\Delta E_v$ , препятствующий их переходу в  $n$ -составляющую, в то время как горячие электроны, сохранившие достаточную энергию при подходе к границе раздела, благополучно переходят в CdS.

На рис. 2 (кривая 2) представлено спектральное распределение  $Q_e$  фотопреобразователя с толщиной  $\sim 150 \text{ \AA}$ . Как видно, фоточувствительность структуры существенно увеличилась. С использованием полученных в настоящей работе кривых  $T(\lambda)$  для рассматриваемых толщин  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  400 и  $150 \text{ \AA}$  были рассчитаны функции  $Q_i = Q_e/T$  (кривые 3 и 4). Очевидно, что при отсутствии фоточувствительности

$\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  внутренняя квантовая эффективность  $Q_i$ , связанная с генерацией носителей тока в  $\text{CdS}$ , при уменьшении толщины  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  не должна изменяться, т.е. кривые 3 и 4 должны были бы совпадать.

Резкое отличие хода кривых в коротковолновой области спектра свидетельствует о том, что рост внешней квантовой эффективности с уменьшением толщины превосходит по величине степень возрастания пропускания пленки  $T$ , причем величина  $Q_e/T$  в случае толщины 150 Å в максимуме превышает единицу. Указанные факты однозначно свидетельствуют об "очувствлении" пленки  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$ , т.е. о возросшем с уменьшением ее толщины вкладе в фототок горячих электронов, генерированных в ней коротковолновым излучением.

Предельное уменьшение толщины  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  ограничивается несколькими факторами. Рассмотрим основные из них. При уменьшении толщины пленки  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$ , выращенная на рельефной поверхности поликристаллического  $\text{CdS}$ , может оказаться разрывной, что приведет к увеличению слоевого сопротивления прозрачной составляющей ФП.

Исследования на растровом электронном микроскопе МРЭМ-200 в совмещенном режиме вторичной электронной эмиссии и тока, индуцированного электронным зондом, обнаружили достаточно высокую степень неразрывности тонкой ( $\sim 150$  Å) пленки  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  на рельефной поверхности поликристаллического слоя  $\text{CdS}$ .

Еще один нежелательный эффект, связанный с предельным уменьшением толщины  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$ , определяется возможностью образования при взаимодействии с кислородом слоев окиси меди с толщиной, сравнимой с толщиной слоя  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$ . Анализ элементарного состава, проведенный на Оже-спектрометре 09-ИОС-10-005 при послойном стравливании пленки  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$ , не обнаружил указанных окисных слоев меди.

Итак, уменьшение толщины слоя  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  до значений  $\sim 150$  Å сохраняет последовательное сопротивление ФП в допустимых пределах, что согласуется с полученными в настоящей работе экспериментальными данными. Возможность использования предельно тонких слоев вырожденного  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  позволяет увеличить фоточувствительность поверхностью-барьерной структуры за счет уменьшения до минимума потерь на нефотоактивное поглощение света в УФ области спектра. Последнее определяется тем, что при указанных толщинах, кроме увеличения пропускания  $T$ , становится существенным вклад в фототок фотоэмиссии носителей (транспорт горячих электронов) из  $\text{Cu}_{1.8}\text{S}$  в  $\text{CdS}$ .

## Список литературы

- [1] Павелец С.Ю., Федорус Г.А., Кононец Я.Ф. // ФТП. 1970. Т. 4. В. 2. С. 347–349.
- [2] Комащенко В.Н., Павелец С.Ю., Федорус Г.А. // Полупроводниковая техника и микроэлектроника. 1980. В. 32. С. 40–42.
- [3] Горбик П.П., Комащенко В.Н., Федорус Г.А. // ФТП. 1980. Т. 14. В. 7. С. 1276–1280.
- [4] Павелец С.Ю., Папидзе И.В. // ЖТФ. 1981. Т. 51. В. 11. С. 2388–2390.
- [5] Павелец С.Ю., Сванидзе Т.М., Тарасенко В.П. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 7. С. 1330–1332.
- [6] Павелец С.Ю., Сванидзе Т.М., Тарасенко В.П. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 11. С. 2058–2060.
- [7] Кантария Р.В., Павелец С.Ю. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 6. С. 1214–1217.
- [8] Власенко Н.А., Кононец Я.Ф. // УФЖ. 1971. Т. 16. № 3. С. 273–241.

Институт физики полупроводников  
Киев, Украина

Поступило в Редакцию  
20 февраля 1994 г.